深圳市安浩芯科技有限公司
SHENZHEN ANHAOXIN TECHNOLOGY CO.,LTD

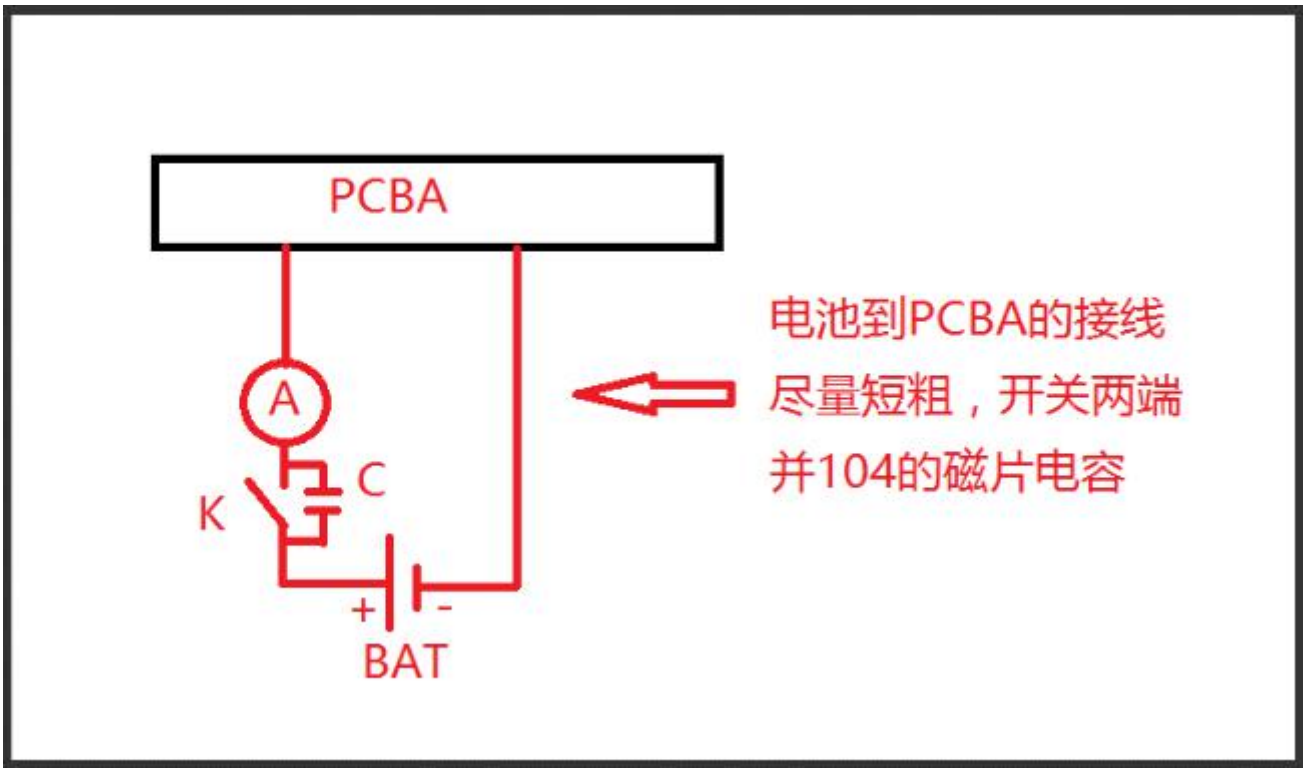
客户生产过程中问题总汇

1. 接收端电池反接造成接收 IC 损坏；

2. 发射端成品电源线焊反，导致发射 IC 损坏；

3. 成品线圈组装不规范，造成线圈脱落，移位，线圈断裂短路等造成充电异常；

4. 测试架设计不规范：接线过长、测试针偏位、线材过细、PCBA 测试架开关两端未接滤波电容，在测试过程中，开关造成纹波尖峰，有几率导致测试问题，IC 损坏；



5. 发射线圈和接收线圈，线圈的正负极焊反、线圈虚焊，线圈正负极短接等造成充电异常；

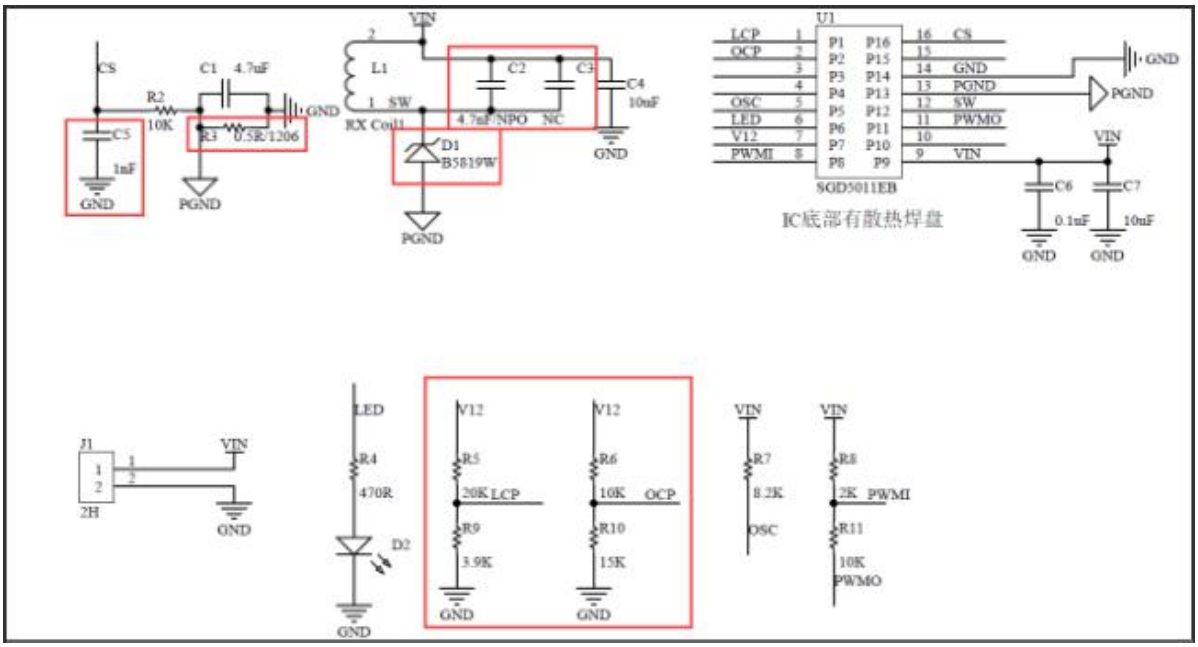
6. 电容电阻等元器件的虚焊，断路，短路造成 PCBA 功能异常；

7. 生产线上的防静电措施不到位，造成部分 IC 静电击穿损坏、部分功能损坏：充电功能、锂电保护功能；

8. 焊接线圈时应先焊接线圈负极 L-后再焊接线圈正极 L+（发射先焊 SW 端，接收先焊 GND/B-端）；

9. 生产开始前应检查设备（测试设备接地、焊接设备接地、防静电设施等是否正常）；

10. 无线充设计时参数余量不足，电容电阻等元器件参数偏差过大，导致充电异常；



发射原理图

C2、C3：为 NPO 材质的电容，参数具体调试后确定；

C5：容值为 1nF/10%精度的电容；

D1：为肖特基：B5819W/SOD-123 封装；

R3：为检流电阻，参数具体调试后确定，0805/1206 封装，精度为 1%；

R5、R6、R9、R10 的电阻用于调试最小电流、过流等参数设定；